

# ALPHA<sup>®</sup> OM-220 焊膏

## 超低温焊接 (ULTS) 解决方案

### 焊接热敏感元件 (<150 °C)

ALPHA OM-220是一种新型超低温焊膏,与ALPHA ULT1合金配合使用,为温度敏感组件和基板进行焊接。

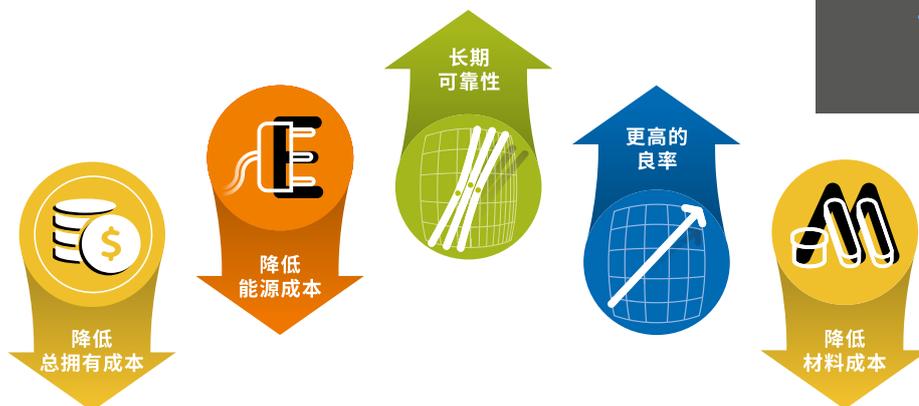
这种创新化学产品可将峰值回流温度降低到低于150 °C,非常适合焊接热敏元件和组件。此外,ALPHA OM-220允许多层/分层焊接以及新型封闭密封解决方案。

此技术适用于各种应用,包括热敏感元件专配,终端应用,例如消费电子、车箱内部电子以及医疗器材。

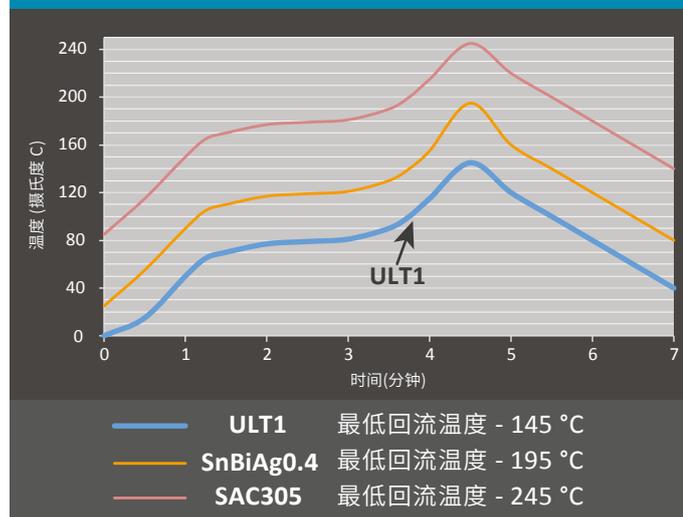


### 主要特性优点

- 低回流峰值温度 (<150 °C)
- 可使用更低成本零件和基材
- 与SAC工艺相比,减少了(零件和基材)翘曲
- 优异的电气可靠性;满足JIS Z 3197&J-STD-004B标准表面绝缘阻力测试要求
- 空洞水平低,在BGA组件上达到IPC-7095第3级要求
- 符合无卤化物和完全不含卤素标准



#### 合金的最低回流峰值温度要求

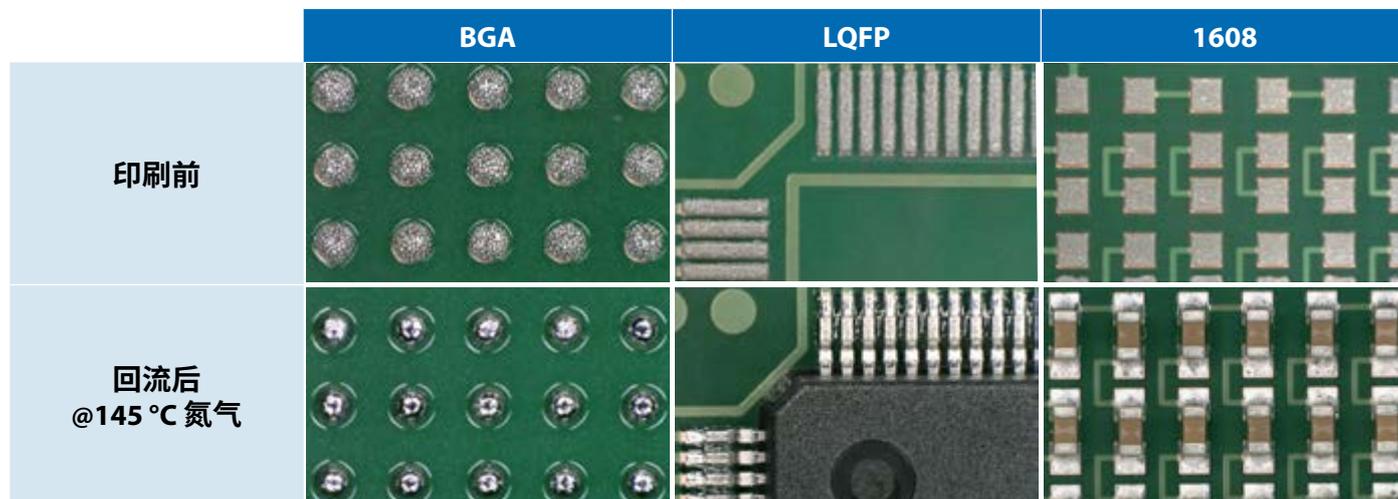


\* 完全不含卤素的定义为无特意添卤素。

# ALPHA<sup>®</sup> OM-220

超低温焊接 (ULTS) 解决方案

ALPHA OM-220 ULT1的焊点均匀闪亮，带有透明柔软助焊剂残留。



## 性能总结

工艺优点	属性	性能表现
印刷工艺窗口	精细间距印刷	230 micron BGA 圆形 (区域比 = 0.57)
	黏力/网版寿命	8 小时 网板寿命
	印刷速度范围	50 至 100 mm/s (2 至 4 in/sec)
回流良率	回流环境	氮气
	抗空洞性能	超过 IPC-7095 第 3 级要求
	随机焊球	符合 IPC J-STD-005A 标准 - 可接受
	熔融 (氮气回流)	在小至170 微米级别有良好的熔融性能
电气可靠性	助焊剂残留物特性	透明、无色 & 柔软
	IPC 表面绝缘阻抗	符合 IPC J-STD-004B TM 2.6.3.7
	JIS 表面绝缘阻抗类别	符合 JIS Z 3197 ROL0, 根据 IPC J-STD-004B
环保	卤素含量	完全不含卤素



macdermidalpha.com  
February 2021

Alpha is a product brand of MacDermid Alpha Electronics Solutions.

欲了解更多信息, 请联系 [Assembly@MacDermidAlpha.com](mailto:Assembly@MacDermidAlpha.com)

© 2021 MacDermid, Inc. and its group of companies. All rights reserved.

® and ™ are registered trademarks or trademarks of MacDermid, Inc. and its group of companies in the United States and/or other countries.